

1. Wiadomości ogólne	13
1.1. Wymagania sprzętowe	14
1.2. Dostępność oprogramowania	15
1.3. Organizacja pracy	15
1.4. Obieg dokumentów	16
1.5. Zgodność formatu projektów i bibliotek	18
2. Instalacja oprogramowania	23
2.1. Instalacja	24
2.2. Weryfikacja instalacji	30
2.3. Wybór wersji	30
2.4. Usuwanie oprogramowania	32
2.5. Konfiguracja licencji	32
3. Obsługa edytora schematów	35
3.1. Rozpoczęcie pracy	36
3.2. Podstawy użytkowania edytora schematów	37
3.2.1. Środowisko pracy	37
3.2.2. Wybieranie funkcji	38
3.2.3. Zarządzanie widokiem	39
3.2.3.1. Nawigacja za pomocą myszki	39
3.2.3.2. Nawigacja za pomocą klawiatury numerycznej	41
3.2.3.3. Nawigacja za pomocą poleceń z menu	43
3.2.3.4. Nawigacja za pomocą okna statusu	43
3.2.3.5. Narzędzie eksploratora	43
3.2.3.5.1. Rozwijanie struktury schematu	48
3.2.3.5.2. Opcje wyszukiwania obiektów	49
3.2.3.5.3. Zmiany wyświetlania okna eksploratora	50

3.3.6.	Zaznaczanie obiektów	50
3.3.6.1.	Ustawianie zakresu aktywnych obiektów	50
3.3.6.2.	Zaznaczanie pojedynczych obiektów	50
3.3.6.3.	Zaznaczanie grup obiektów	51
3.3.7.	Wyszukiwanie obiektów	52
3.3.7.1.	Wyszukiwanie pojedynczych elementów	52
3.3.7.2.	Wyszukiwanie wyprowadzeń	53
3.3.7.3.	Wyszukiwanie połączeń w sieci logicznej.....	53
3.3.7.4.	Wyszukiwanie punktu o podanych współrzędnych.....	54
3.3.8.	Edycja właściwości obiektów	55
3.3.8.1.	Edycja właściwości elementu.....	56
3.3.8.1.1.	Wyświetlanie etykiet opisujących właściwości elementu na schemacie	57
3.3.8.1.2.	Edycja atrybutów.....	58
3.3.8.1.3.	Przypisanie obudowy.....	58
3.3.8.1.4.	Edycja wyprowadzeń sygnałowych.....	58
3.3.8.2.	Edycja właściwości wyprowadzenia.....	59
3.3.8.3.	Edycja właściwości połączeń logicznych	60
3.3.8.4.	Edycja właściwości magistral sygnałowych.....	61
3.3.8.5.	Edycja właściwości obiektów rysunkowych	62
3.3.9.	Okno komunikatów.....	64
3.4.	Przegląd poleceń menu edytora schematów.....	64
3.4.1.	Sekcja pliku (<i>File</i>)	65
3.4.2.	Sekcja edycji (<i>Edit</i>)	65
3.4.3.	Sekcja widoku (<i>View</i>).....	67
3.4.4.	Sekcja ustawień (<i>Setup</i>).....	69
3.4.5.	Sekcja narzędzi (<i>Tools</i>).....	70
3.4.6.	Sekcja pomocy (<i>Help</i>).....	72
3.5.	Paski narzędzi edytora schematów	73
3.5.1.	Pasek standardowy (<i>Standard Toolbar</i>)	73
3.5.2.	Pasek edycji schematu (<i>Schematic Editing Toolbar</i>)	73
3.5.3.	Pasek wyboru (<i>Selection Toolbar</i>).....	73
3.5.4.	Dostosowanie wyglądu pasków narzędzi	76
3.6.	Przegląd poleceń menu kontekstowego.....	77
3.6.1.	Ogólne menu kontekstowe edytora.....	77

3.6.2. Menu kontekstowe dla obiektów projektowych	78
3.6.2.1. Menu kontekstowe dla elementu.....	78
3.6.2.2. Menu kontekstowe dla etykiet opisujących element	80
3.6.2.3. Menu kontekstowe dla połączeń logicznych	81
3.6.3. Menu kontekstowe dla obiektów rysunkowych.....	81
3.7. Definiowanie właściwości schematu	83
3.7.1. Zakładka parametrów ogólnych (<i>General</i>).....	83
3.7.2. Zakładka parametrów projektu (<i>Design</i>)	85
3.7.3. Zakładki właściwości linii (<i>Line Widths</i>) i tekstu (<i>Text</i>)	88
3.8. Wymiana danych z programami <i>PADS Layout</i> i <i>PADS Router</i>	89
3.8.1. Połaczenie z programem <i>PADS Layout</i>	89
3.8.1.1. Zakładka wyboru (<i>Selection</i>)	90
3.8.1.2. Zakładka projektu (<i>Design</i>).....	91
3.8.1.3. Zakładka dokumentu (<i>Document</i>).....	92
3.8.1.4. Zakładka właściwości (<i>Preferences</i>).....	92
3.8.1.5. Zakładka zmian (<i>ECO Names</i>).....	93
3.8.2. Połaczenie z programem <i>PADS Router</i>	93
4. Obsługa edytora płyt drukowanych	95
4.1. Rozpoczęcie pracy	96
4.2. Podstawy użytkowania edytora płyt drukowanych.....	96
4.3. Struktura projektu płytki drukowanej	97
4.3.1. Wyświetlanie kolorów w trybie edycji płytki drukowanej	102
4.3.2. Definicja warstw	107
4.3.2.1. Określanie właściwości warstw elektrycznych.....	107
4.3.2.2. Określanie właściwości warstw niewielkiej elektrycznych.....	110
4.3.2.3. Budowa płytki drukowanej.....	111
4.3.2.4. Rozszerzenie liczby warstw w projekcie.....	112
4.3.2.5. Sposoby wyświetlania widoku	113
4.3.2.5.1. Tryb normalny	114
4.3.2.5.2. Tryb przezroczysty (<i>Transparent mode</i>).....	114
4.3.2.5.3. Tryb komplementarny (<i>Complementary mode</i>).....	114
4.3.2.5.4. Tryb zarysowy (<i>Outline mode</i>)	114
4.3.3. Zaznaczanie i wyszukiwanie obiektów	114

4.3.4. Edycja właściwości obiektów	115
4.3.4.1. Edycja właściwości elementu	115
4.3.4.2. Edycja właściwości wyprowadzeń i przelotek	118
4.3.4.3. Edycja właściwości ścieżek	119
4.3.4.4. Edycja właściwości kształtu rysunkowego	119
4.3.4.5. Odczyt i modyfikacja właściwości obiektów tekstowych	119
4.3.5. Eksplorator projektu (<i>Project Explorer</i>)	121
4.3.6. Wyszukiwarka (<i>Find</i>)	121
4.4. Przegląd poleceń menu edytora płyt drukowanych	122
4.4.1. Sekcja pliku (<i>File</i>)	123
4.4.2. Sekcja edycji (<i>Edit</i>)	124
4.4.3. Sekcja widoku (<i>View</i>)	126
4.4.4. Sekcja ustawień (<i>Setup</i>)	128
4.4.5. Sekcja narzędzi (<i>Tools</i>)	129
4.4.6. Sekcja pomocy (<i>Help</i>)	131
4.5. Paski narzędzi edytora płyt drukowanych	132
4.5.1. Pasek standardowy (<i>Standard Toolbar</i>)	132
4.5.2. Pasek projektowania (<i>Design Toolbar</i>)	132
4.5.3. Pasek rysowania (<i>Drafting Toolbar</i>)	132
4.5.4. Pasek wymiarowania (<i>Dimensioning Toolbar</i>)	135
4.5.5. Pasek zmian (<i>ECO Toolbar</i>)	136
4.5.6. Pasek narzędzi BGA (<i>BGA Toolbar</i>)	136
4.5.7. Dostosowanie wyglądu pasków narzędzi	137
4.6. Przegląd poleceń menu kontekstowego	137
4.7. Definiowanie właściwości projektu płytki drukowanej	138
4.7.1. Zakładka parametrów ogólnych (<i>Global</i>)	138
4.7.2. Zakładka projektu (<i>Design</i>)	140
4.7.3. Zakładka prowadzenia ścieżek (<i>Routing</i>)	143
4.7.4. Zakładka połączeń termicznych (<i>Thermals</i>)	145
4.7.5. Zakładka wymiarowania (<i>Dimensining</i>)	147
4.7.6. Zakładka stylu zakończenia ścieżki (<i>Teardrops</i>)	148
4.7.7. Zakładka rysowania (<i>Drafting</i>)	149
4.7.8. Zakładka rastrów (<i>Grids</i>)	150
4.7.9. Zakładka rozdzielanej miedzi (<i>Split/Mixed Plane</i>)	151
4.7.10. Zakładka szablonów przelotek (<i>Via Patterns</i>)	154

5. Biblioteki w programie PADS	157
5.1. Organizacja biblioteki.....	158
5.2. Obsługa edytora biblioteki <i>Part Editor</i>	163
5.2.1. Definicja elementu w bibliotece.....	163
5.2.2. Definicja symbolu w bibliotece.....	167
5.2.3. Przegląd polecień menu	168
5.2.3.1. Sekcja pliku (<i>File</i>).....	169
5.2.3.2. Sekcja edycji (<i>Edit</i>)	170
5.2.3.3. Sekcja widoku (<i>View</i>)	170
5.2.3.4. Sekcja ustawień (<i>Setup</i>)	170
5.2.3.5. Sekcja narzędzi (<i>Tools</i>)	170
5.2.4. Paski narzędzi.....	171
5.3. Obsługa edytora biblioteki <i>PCB Decal Editor</i>	171
5.3.1. Definicja obudowy w bibliotece	173
5.3.2. Przegląd polecień menu	174
5.3.2.1. Sekcja pliku (<i>File</i>).....	174
5.3.2.2. Sekcja edycji (<i>Edit</i>)	177
5.3.2.3 Sekcja widoku (<i>View</i>)	177
5.3.2.4. Sekcja ustawień (<i>Setup</i>)	177
5.3.2.5. Sekcja narzędzi (<i>Tools</i>)	178
5.3.3. Paski narzędzi.....	179
5.4. Tworzenie bibliotek.....	180
5.4.1. Definiowanie elementu (<i>Part Type</i>).....	180
5.4.1.1. Zakładka informacji ogólnych (<i>General</i>).....	183
5.4.1.2. Zakładka obudowy (<i>PCB Decals</i>)	184
5.4.1.3. Zakładka symboli (<i>Gates</i>).....	185
5.4.1.4. Zakładka wyprowadzeń (<i>Pins</i>).....	187
5.4.1.5. Zakładka atrybutów (<i>Attributes</i>).....	189
5.4.1.6. Zakładka mapowania wyprowadzeń (<i>Pin Mapping</i>).....	190
5.4.1.7. Zakładka konektorów (<i>Connectors</i>).....	191
5.4.1.8. Zapis elementu do biblioteki.....	192
5.4.2. Edycja symboli graficznych (<i>CAE Decal, Pin Decal</i>).....	193
5.4.2.1. Edycja symbolu elementu (<i>CAE Decal</i>)	193
5.4.2.2. Edycja symbolu wyprowadzenia (<i>Pin Decal</i>)	196
5.4.3. Elementy logiczne specjalne (<i>Off-Page, Power, Ground</i>)	198

5.4.4. Projektowanie obudowy PCB (<i>PCB Decal</i>)	200
5.4.4.1. Dodawanie pól lutowniczych	201
5.4.4.2. Rysowanie linii obrysu.....	205
5.4.4.3. Dodawanie etykiet	208
5.4.4.4. Obudowy alternatywne	208
5.4.4.5. Reguły tworzenia obudów PCB.....	209
5.4.4.6. Narzędzie kreatora obudów (<i>Pin Wizard</i>)	211
5.4.4.7. Przypisywanie atrybutów	212
5.4.4.8. Zapis do biblioteki	213
5.4.5. Tworzenie rysunków (<i>Lines</i>)	213
6. Projekt od A do Z	215
6.1. Tworzenie schematu.....	216
6.1.1. Przygotowanie do pracy	216
6.1.2. Rozmieszczanie elementów	219
6.1.2.1. Pobieranie elementów z biblioteki.....	219
6.1.2.2. Graficzne symbole alternatywne	220
6.1.2.3. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie elementów	221
6.1.2.4. Układanie serii elementów	222
6.1.2.5. Elementy złożone	222
6.1.2.6. Nadawanie oznaczeń.....	223
6.1.3. Prowadzenie połączeń.....	224
6.1.3.1. Połączenia specjalne.....	226
6.1.3.2. Nazewnictwo połączeń.....	226
6.1.3.3. Magistrale sygnałowe	227
6.1.3.4. Symbole hierarchiczne	229
6.1.4. Przegląd schematu.....	230
6.1.5. Rysunki i tekst w schemacie	231
6.1.6. Reguły projektowe	234
6.1.6.1. Budowa płytki drukowanej.....	234
6.1.6.2. Organizacja reguł projektowych w edytorze <i>PADS Logic</i>	235
6.1.6.3. Kategoria reguł odległości (<i>Clearance</i>).....	237
6.1.6.4. Kategoria reguł prowadzenia ścieżek (<i>Routing</i>).....	238
6.1.6.5. Kategoria reguł szybkich sygnałów cyfrowych (<i>Hi Speed</i>)	239
6.1.6.6. Poziomy reguł dla klas i sieci logicznych.....	239
6.2. Projektowanie płytki drukowanej	240
6.2.1. Przygotowanie do pracy	241
6.2.1.1. Definicja warstw.....	242
6.2.1.2. Definicja przelotek.....	243

6.2.1.3.	Obrys płytki drukowanej	246
6.2.1.4.	Import rysunków z plików DXF.....	247
6.2.1.5.	Obszary z ograniczeniami.....	251
6.2.1.6.	Dodatkowe elementy wprowadzane na projekt	252
6.2.1.7.	Przenoszenie listy połączeń i definicji reguł projektowych ze schematu	253
6.2.2.	Rozszerzone reguły projektowe	253
6.2.2.1.	Organizacja reguł projektowych w edytorze <i>PADS Layout</i>	255
6.2.2.2.	Wybór aktywnych przelotek	256
6.2.2.3.	Reguły warunkowe (<i>Conditional Rules</i>)	257
6.2.2.4.	Reguły prowadzenia par różnicowych (<i>Differential Pairs</i>)	258
6.2.3.	Rozmieszczanie elementów	259
6.2.4.	Prowadzenie ścieżek.....	263
6.2.4.1.	Ustawienia rastra	265
6.2.4.2.	Wybór aktywnej przelotki.....	265
6.2.4.3.	Połączenia typu <i>Fanout</i>	266
6.2.4.4.	Praca w trybie <i>On-line DRC</i>	268
6.2.5.	Przegląd projektu	270
6.2.6.	Tworzenie obszarów miedzi	274
6.2.6.1.	Rysowanie miedzi	274
6.2.6.2.	Wylewanie miedzi.....	280
6.2.6.3.	Miedź typu <i>Chamfered Path</i> w obwodach w.cz.....	282
6.2.7.	Wstawianie dodatkowych przelotek	284
6.2.7.1.	Funkcje automatycznego dodawania przelotek	285
6.2.7.2.	Ręczne dodawanie przelotek.....	287
6.2.7.3.	Przesuwanie i usuwanie przelotek	289
6.2.8.	Rysunki i tekst w projekcie płytki drukowanej	289
6.2.8.1.	Tworzenie linii rysunkowych.....	289
6.2.8.2.	Tworzenie tekstu.....	291
6.2.8.3.	Inne obiekty niewielkie	291
6.3.	Weryfikacja projektu	292
6.3.1.	Weryfikacja schematu	292
6.3.1.1.	Weryfikacja elektryczna	292
6.3.1.2.	Weryfikacja listy połączeń	292
6.3.2.	Kontrola poprawności projektu płytki drukowanej	293
6.3.2.1.	Weryfikacja reguł projektowych (<i>Clearance/Latium</i>).....	294
6.3.2.2.	Weryfikacja ciągłości połączeń (<i>Connectivity</i>)	295

6.3.2.3. Weryfikacja obszarów miedzi wylewanej (<i>Plane</i>)	296
6.3.2.4. Weryfikacja parametrów elektrodynamicznych (<i>High Speed</i>).....	296
6.3.2.5. Weryfikacja parametrów technologicznych (<i>Fabrication</i>).....	297
6.3.3. Weryfikacja mechaniczna płytki drukowanej	297
6.3.3.1. Weryfikacja modelu 2D	298
6.3.3.2. Weryfikacja modelu 3D	298
6.4. Zmiany w projekcie	301
6.4.1. Wprowadzanie zmian w schemacie.....	302
6.4.1.1. Zmiana oznaczenia elementu.....	302
6.4.1.2. Zmiana wartości atrybutów	303
6.4.1.3. Zmiana typu i aktualizacja definicji elementu	304
6.4.2. Przenoszenie zmian na projekt PCB (<i>ECO to PCB</i>)	305
6.4.3. Zmiany w projekcie płytki drukowanej.....	309
6.4.3.1. Dodawanie elementów z biblioteki	309
6.4.3.2. Dodawanie i modyfikacja połączeń i sieci logicznych	309
6.4.3.3. Usuwanie obiektów	310
6.4.3.4. Zmiana typu i aktualizacja definicji elementu	310
6.4.3.5. Zmiana i aktualizacja definicji obudowy	312
6.4.3.6. Zmiany w definicji pól lutowniczych i przelotek	313
6.4.3.7. Zmiana oznaczeń elementów.....	316
6.4.4. Przenoszenie zmian z projektu PCB na schemat (<i>ECO from PCB</i>)	317
6.4.5. Wprowadzanie zmian do projektu w praktyce	318
6.5. Ponowne użycie gotowego projektu	320
6.5.1. Wykorzystanie rysunków z biblioteki (<i>Lines</i>)	320
6.5.2. Kopiowanie fragmentów schematu (<i>Group</i>)	321
6.5.3. Użycie gotowych rozwiązań dla projektu płytki drukowanej (<i>Reuse</i>)	323
6.5.4. Modyfikacja plików startowych.....	331
6.6. Wykrywanie i naprawa uszkodzeń pliku projektu.....	331
7. Przygotowanie dokumentacji	333
7.1. Tworzenie dokumentacji schematu	334
7.1.1. Dodawanie nagłówków (<i>Fields</i>).....	334
7.1.2. Dodawanie obiektów OLE	335
7.1.3. Drukowanie	336
7.1.4. Plotowanie	339
7.1.5. Dokumentacja w formacie PDF	339

7.1.6. Raporty	340
7.1.7. Tworzenie zestawienia materiałów (<i>BOM</i>).....	341
7.2. Tworzenie dokumentacji płytki drukowanej.....	344
7.2.1. Konfiguracja dokumentów w oknie <i>CAM</i>	345
7.2.2. Dokumentacja obwodu drukowanego.....	349
7.2.2.1. Dokumentacja dla warstw elektrycznych.....	349
7.2.2.2. Dokumentacja dla warstw nieelektrycznych	352
7.2.2.2.1. Dokumentacja typu <i>Solder Mask</i>	352
7.2.2.2.2. Dokumentacja typu <i>Silkscreen</i>	355
7.2.2.2.3. Dokumentacja typu <i>Paste Mask</i>	357
7.2.2.3. Dokumentacja do programu wiercenia	359
7.2.2.4. Dokumentacja mechaniczna płytka drukowana.....	362
7.2.2.5. Inne rodzaje dokumentacji.....	365
7.2.3. Weryfikacja dokumentacji PCB	367
7.2.4. Dokumentacja obwodu drukowanego do produkcji seryjnej.....	370
7.2.5. Wprowadzanie wariantów montażowych (<i>Assembly Variants</i>)	371
7.2.6. Dokumentacja montażowa	374
7.2.7. Raporty	380
7.2.8. Tworzenie zestawienia materiałów (<i>BOM</i>).....	382
8. Informacje dodatkowe.....	383
8.1. Przebudowa menu programu	384
8.2. Tworzenie makropoleceń	386
8.3. Skróty klawiszowe.....	390
8.3.1. Skróty z klawiszami funkcyjnymi.....	391
8.3.2. Skróty z klawiszami <i>Ctrl/Alt/Shift</i>	391
8.3.3. Skróty dla komend <i>Modeless Commands</i>	392
8.3.3.1. Komendy ogólne	392
8.3.3.2. Komendy do pracy z siatką rastrową.....	393
8.3.3.3. Komenda wyszukiwania (<i>Search</i>)	394
8.3.3.4. Komendy łamania linii i ścieżek	394
8.3.3.5. Komendy cofania i ponawiania poleceń.....	394
8.3.3.6. Komendy trybu DRC	394
8.3.3.7. Komendy prowadzenia ścieżek.....	395
8.3.3.8. Komendy dla miedzi typu <i>Plane Area</i> na warstwach <i>Split/Mixed</i>	395

8.3.3.9.	Komendy rysowania	395
8.3.3.10.	Komendy zmiany jednostki roboczej	395
8.3.3.11.	Komendy pomiaru odległości.....	395
8.3.3.12.	Zamienniki użycia przycisków myszki.....	396
8.3.3.13.	Komendy wyświetlania widoku warstw (od wersji PADS 9.0).....	396
8.3.3.14.	Inne komendy	397
8.4.	Przydatne adresy internetowe.....	397